

B760M DS3H AX B760M DS3H B760M DS3H AX DDR4 B760M DS3H DDR4

ユーザーズマニュアル

改版 1303



GIGABYTE は、地球市民としての責任を果たすため、紙の使用量を削減します。また、地球温暖化の影響を軽減するために、本製品の梱包材料はリサイクルおよび再使用可能です。GIGABYTEは、環境を保護するためにお客様と協力いたします。

製品の詳細については、GIGABYTE の Web サイトにアクセスしてください。

著作権

© 2024 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. 著作権所有。

本マニュアルに記載された商標は、それぞれの所有者に対して法的に登録されたものです。

免責条項

このマニュアルの情報は著作権法で保護されており、GIGABYTE に帰属します。このマニュアルの仕様と内容は、GIGABYTE により事前の通知なしに変更されることがあります。本マニュアルのいかなる部分も、GIGABYTE の書面による事前の承諾を受けることなしには、いかなる手段によっても複製、コピー、翻訳、送信または出版することは禁じられています。

- 詳細な製品情報については、ユーザーズマニュアルをよくお読みください。
- 製品を素早くセットアップできるように、GIGABYTE ウェブサイトにあるクイック・インストール・ガイドをご参照ください。

https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb_manual_installation-guide_12QM-100xR.pdf

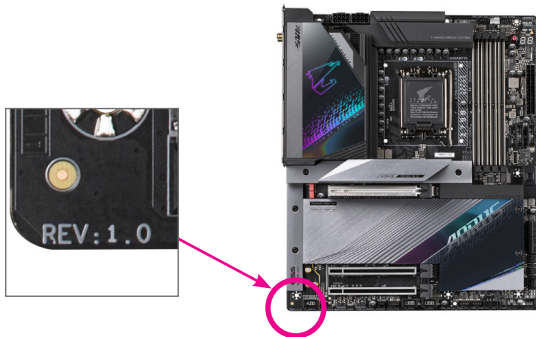
製品関連の情報は、以下の Web サイトを確認してください：

<https://www.gigabyte.com/jp>

マザーボードリビジョンの確認

マザーボードのリビジョン番号は「REV: X.X.」のように表示されます。例えば、「REV: 1.0」はマザーボードのリビジョンが 1.0 であることを意味します。マザーボード BIOS、ドライバを更新する前に、または技術情報をお探しの際は、マザーボードのリビジョンをチェックしてください。

例：



目次

第 1 章	製品紹介.....	4
1-1	マザーボードのレイアウト.....	4
1-2	ボックスの内容.....	6
第 2 章	ハードウェアの取り付け.....	7
2-1	取り付け手順.....	7
2-2	製品の仕様.....	8
2-3	CPU および CPU クーラーの取り付け.....	12
2-4	メモリの取り付け.....	15
2-5	拡張カードを取り付ける.....	16
2-6	背面パネルのコネクター.....	17
2-7	内部コネクター.....	19
第 3 章	BIOS セットアップ.....	31
第 4 章	オペレーティングシステムとドライバをインストールする.....	33
4-1	オペレーティングシステムのインストール.....	33
4-2	ドライバのインストール.....	34
第 5 章	付録.....	35
5-1	RAID セットを設定する.....	35
	Regulatory Notices.....	36
	連絡先.....	40

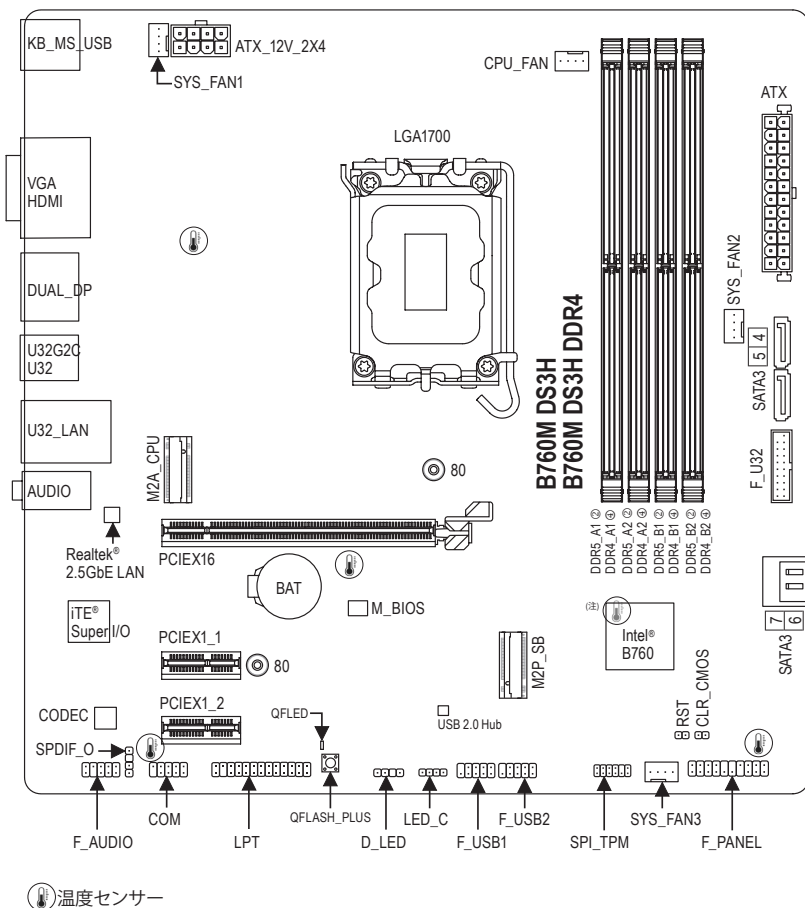
第1章 製品紹介

1-1 マザーボードのレイアウト



(注) 温度センサーはマザーボードの背面にあります。

- ① B760M DS3H AXのみ。
③ B760M DS3H AX DDR4のみ。



(注) 温度センサーはマザーボードの背面にあります。

② B760M DS3Hのみ。

④ B760M DS3H DDR4のみ。

1-2 ボックスの内容

- ☑ B760M DS3H AX、B760M DS3H、B760M DS3H AX DDR4 または
B760M DS3H DDR4 マザーボード
- ☑ ユーザーズマニュアル
- ☑ I/O シールド
- ☑ SATA ケーブル (x2)
- ☑ アンテナ (x1) ①③
- ☑ M.2 ネジ
- ☑ M.2 厚手/薄型ゴムパッド (x1)

* 上記、ボックスの内容は参照用となります。実際の同梱物はお求めいただいた製品パッケージにより異なる場合があります。また、ボックスの内容については、予告なしに変更する場合があります。

- ① B760M DS3H AXのみ。
- ③ B760M DS3H AX DDR4のみ。

第 2 章 ハードウェアの取り付け

2-1 取り付け手順

マザーボードには、静電気放電(ESD)の結果、損傷する可能性のある精巧な電子回路やコンポーネントが数多く含まれています。取り付ける前に、ユーザーズマニュアルをよくお読みになり、以下の手順に従ってください。

- 取り付け前に、PCケースがマザーボードに適していることを確認してください。
- 取り付け前に、マザーボードの S/N (シリアル番号) ステッカーまたはディーラーが提供する保証ステッカーを取り外したり、はがしたりしないでください。これらのステッカーは保証の確認に必要です。
- マザーボードまたはその他のハードウェアコンポーネントを取り付けたり取り外したりする前に、常にコンセントからコードを抜いて電源を切ってください。
- ハードウェアコンポーネントをマザーボードの内部コネクタに接続しているとき、しっかりと安全に接続されていることを確認してください。
- マザーボードを扱う際には、金属リード線やコネクタには触れないでください。
- マザーボード、CPU またはメモリなどの電子コンポーネントを扱うとき、静電気放電 (ESD) リストストラップを着用することをお勧めします。ESD リストストラップをお持ちでない場合、手を乾いた状態に保ち、まず金属に触れて静電気を取り除いてください。
- マザーボードを取り付ける前に、ハードウェアコンポーネントを静電防止パッドの上に置か、静電遮断コンテナの中に入れてください。
- マザーボードから電源装置のケーブルを接続するまたは抜く前に、電源装置がオフになっていることを確認してください。
- パワーをオンにする前に、電源装置の電圧が地域の電源基準に従っていることを確認してください。
- 製品を使用する前に、ハードウェアコンポーネントのすべてのケーブルと電源コネクタが接続されていることを確認してください。
- マザーボードの損傷を防ぐために、ネジがマザーボードの回路やそのコンポーネントに触れないようにしてください。
- マザーボードの上またはコンピュータのケース内部に、ネジや金属コンポーネントが残っていないことを確認してください。
- コンピュータシステムは、平らでない面の上に置かないでください。
- コンピュータシステムを高温または湿った環境に設置しないでください。
- 取り付け中にコンピュータのパワーをオンにすると、システムコンポーネントが損傷するだけでなく、ケガにつながる恐れがあります。
- 取り付けの手順について不明確な場合や、製品の使用に関して疑問がある場合は、正規のコンピュータ技術者にお問い合わせください。
- アダプタ、延長電源ケーブルまたはテーブルタップを使用する場合は、その取り付けおよび接続手順を必ずお問い合わせください。

2-2 製品の仕様

	CPU	• LGA1700ソケット:第14世代、第13世代および第12世代インテル®Core™、Pentium® Gold、Celeron® プロセッサ対応 (最新の CPU サポートリストについては、GIGABYTE の Web サイトにアクセスしてください。) • L3 キャッシュはCPUにより異なります
	チップセット	• Intel® B760 Express チップセット
	メモリ	• 第14世代および第13世代インテル®Core™ i9/i7 プロセッサ: - DDR5 5600/5200/4800/4400 MT/s メモリモジュールのサポート ①② • 第13世代インテル®Core™ i5/i3 および第12世代インテル®Core™、Pentium® Gold、Celeron® プロセッサ: - DDR5 4800/4400 MT/s メモリモジュールのサポート ①② • DDR4 3200/3000/2933/2666/2400/2133 MT/s メモリモジュールのサポート③④ • 最大256 GB (64 GBの単一DIMM容量)のシステムメモリをサポートする 4 x DDR5 DIMMソケット①② • 最大128 GB (32 GBの単一DIMM容量)のシステムメモリをサポートする 4 x DDR4 DIMMソケット③④ • デュアルチャンネルメモリ対応 • ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 メモリモジュールのサポート (非 ECC モードで動作) • 非ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 メモリモジュールのサポート • XMP (エクストリームメモリプロファイル) メモリモジュールのサポート (CPUやメモリの構成によって、対応するメモリの種類、データレート(速度)、DRAM モジュールの数に影響が出る場合がありますので、詳しくは、GIGABYTEのWeb サイトに「メモリサポートリスト」を参照してください。)
	オンボードグラフィックス	• 統合グラフィックスプロセッサ-Intel® HDグラフィックスのサポート: - D-Sub ポート(x1)、1920x1200@60 Hzの最大解像度をサポートします。②④ - HDMIポート(x1)、4096x2160@60 Hzの最大解像度をサポートします。 * HDMI 2.1とHDCP 2.3をサポートしています。 **HDMI 2.1 ネイティブ TMDs 互換ポートに対応。 - DisplayPort(x1)、4096x2304@60 Hzの最大解像度をサポートします。 * DisplayPort/バージョン1.2とHDCP 2.3をサポートしています。 - DisplayPort(x1)、4096x2304@60 Hzの最大解像度をサポートします。 * DisplayPort/バージョン1.2をサポート。 (グラフィックス出力の仕様は、CPU 毎の対応状況により異なる場合があります。) • 最大3画面の同時表示をサポート①③ • 最大4画面の同時表示をサポート②④
	オーディオ	• Realtek® オーディオコーデック • ハイディフィニションオーディオ • 2/4/5/17.1 チャンネル * オーディオソフトウェアを使って、オーディオジャックの機能を変更することができます。7.1ch オーディオを設定するには、オーディオソフトウェアにて、設定を行ってください。 • S/PDIFアウトのサポート

① B760M DS3H AXのみ。

② B760M DS3Hのみ。

③ B760M DS3H AX DDR4のみ。

④ B760M DS3H DDR4のみ。

 LAN	◆ Realtek® 2.5GbE LAN チップ (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
 無線通信モジュール①③	◆ AMD Wi-Fi 6E RZ608 (MT7921K) (PCB rev. 1.0) - WiFi a, b, g, n, ac, ax 規格の 2.4/5/6 GHz 信号キャリア周波数帯域対応 - BLUETOOTH 5.2 - 11ax 80MHzワイヤレス規格に対応し ◆ Intel® Wi-Fi 6E AX210 (PCB rev. 1.1) - WiFi a, b, g, n, ac, ax 規格の 2.4/5/6 GHz 信号キャリア周波数帯域対応 - BLUETOOTH 5.3 - 11ax 80MHzワイヤレス規格に対応し ◆ Intel® Wi-Fi 6E AX211 (PCB rev. 1.2) - WiFi a, b, g, n, ac, ax 規格の 2.4/5/6 GHz 信号キャリア周波数帯域対応 - BLUETOOTH 5.3 - 11ax 160MHzワイヤレス規格に対応し ◆ Realtek® Wi-Fi 6E RTL8852CE (PCB rev. 1.3) - WiFi a, b, g, n, ac, ax 規格の 2.4/5/6 GHz 信号キャリア周波数帯域対応 - BLUETOOTH 5.3 - 11ax 160MHzワイヤレス規格に対応し (実際のデータ転送速度は、ご使用の機器構成によって異なる場合があります。)
 拡張スロット	◆ CPU: - PCIe 4.0 をサポートし、x16で動作する 1 x PCI Express x16 スロット * PCIe16スロットは、グラフィックスカードまたはNVMe SSDにのみ対応しています。 ◆ チップセット: - PCIe 3.0 をサポートし、x1で動作する 2 x PCI Express x1 スロット
 ストレージインターフェイス	◆ CPU: - M.2 コネクタ (x1) (Socket 3、M key、タイプ 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD 対応) (M2A_CPU) ◆ チップセット: - M.2 コネクタ (x1) (Socket 3、M key、タイプ 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD 対応) (M2P_SB) - SATA 6Gb/s コネクタ (x4) ◆ SATA ストレージデバイスの RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10 サポート
 USB	◆ チップセット: - 背面パネルに USB 3.2 Gen 2 対応USB Type-C®ポート搭載 (x1) - USB 3.2 Gen 1ポート (x5) (背面パネルに3つのポート、内部USBヘッダを通して2ポートが使用可能) - 背面パネルに USB 2.0/1.1 ポート (x2) ◆ チップセット+USB 2.0 ハブ: - USB 2.0/1.1ポート (x4) 内部USBヘッダ経由で使用可能

① B760M DS3H AXのみ。

② B760M DS3Hのみ。

③ B760M DS3H AX DDR4のみ。

④ B760M DS3H DDR4のみ。

	内部コネクター	◆ 24 ピン ATX メイン電源コネクター (x1) ◆ 8 ピン ATX 12V 電源コネクター (x1) ◆ CPU ファンヘッダ (x1) ◆ システムファンヘッダ (x3) ◆ Addressable LEDテープ用ヘッダ (x1) ◆ RGB LEDテープ用ヘッダ (x1) ◆ M.2 ソケット3 コネクター (x2) ◆ SATA 6Gb/s コネクター (x4) ◆ 前面パネルヘッダ (x1) ◆ 前面パネルオーディオヘッダ (x1) ◆ USB 3.2 Gen 1 ヘッダ (x1) ◆ USB 2.0/1.1 ヘッダ (x2) ◆ TPMモジュール用ヘッダ (x1) (GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0/ GC-TPM2.0 SPI V2 モジュールのみ対応) ◆ シリアルポートヘッダ (x1)②④ ◆ パラレルポートヘッダ (x1)②④ ◆ S/PDIF 出力ヘッダ (x1) ◆ Q-Flash Plus ボタン (x1) ◆ リセットジャンパ (x1) ◆ CMOSクリアジャンパ (x1)
	背面パネルの コネクター	◆ USB 2.0/1.1ポート (x2) ◆ PS/2 キーボード/マウスポート (x1) ◆ SMA アンテナ用コネクター (2T2R) (x2)①③ ◆ D-Subポート (x1)③②④ ◆ HDMIポート (x1)③② ◆ DisplayPort (x2)③② ◆ USB 3.2 Gen 1 ポート (x3) ◆ USB 3.2 Gen 2 に対応する USB Type-C®ポート (x1) ◆ RJ-45ポート (x1) ◆ オーディオジャック (x3)
	I/O コントロー ラー	◆ iTE® I/O コントローラーチップ
	ハードウェア モニタ	◆ 電圧検知 ◆ 温度検知 ◆ ファン速度検知 ◆ 水冷流量検知 ◆ ファン異常検知 ◆ ファン速度コントロール * ファン速度コントロール機能のサポートについては、取り付けたクーラーによって異なります。
	BIOS	◆ 128 Mbit フラッシュ (x1) ◆ 正規ライセンス版AMI UEFI BIOSを搭載 ◆ PnP 1.0a、DMI 2.7、WfM 2.0、SM BIOS 2.7、ACPI 5.0

(注) 実際のサポートはCPUによって異なる場合があります。

① B760M DS3H AXのみ。

③ B760M DS3H AX DDR4のみ。

② B760M DS3Hのみ。

④ B760M DS3H DDR4のみ。

 独自機能	- GIGABYTE Control Center (GCC) のサポート * GCC で使用可能なアプリケーションは、マザーボードのモデルによって異なります。各アプリケーションのサポート機能もマザーボードのモデルによって異なります。 - Q-Flash のサポート - Q-Flash Plus のサポート
 バンドルされたソフトウェア	- Norton® インターネットセキュリティ (OEM バージョン) - LAN bandwidth management software
 オペレーティングシステム	- Windows 11 64-bit のサポート - Windows 10 64-bit のサポート
 フォームファクタ	マイクロ ATX フォームファクタ、24.4cm x 24.4cm

* GIGABYTE は、予告なしに製品仕様と製品関連の情報を変更する場合があります。

☞ アプリの最新バージョンをダウンロードするには、GIGABYTE の Web サイトのサポートユーティリティページにアクセスしてください。

<https://www.gigabyte.com/jp/Support/Utility/Motherboard?m=ut>

2-3 CPU および CPU クーラーの取り付け

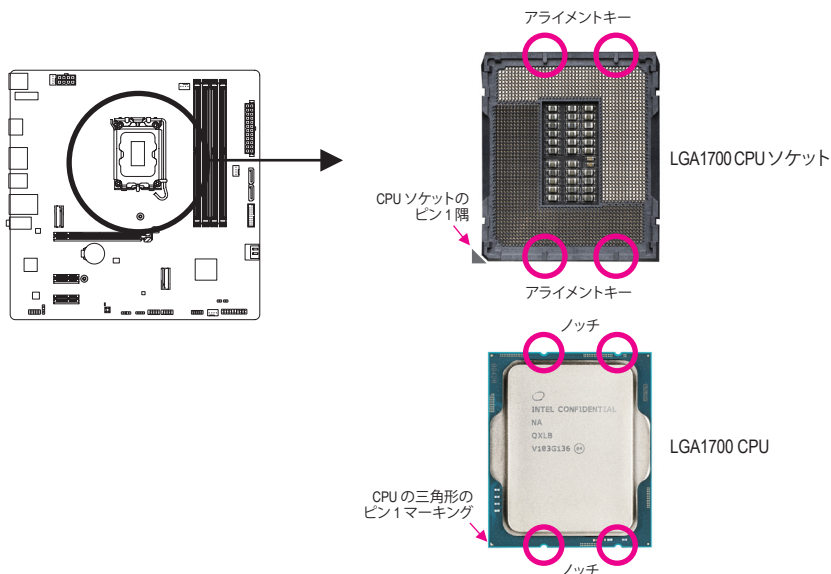


CPU を取り付ける前に次のガイドラインをお読みください：

- マザーボードが CPU をサポートしていることを確認してください。
(最新の CPU サポートリストについては、GIGABYTE の Web サイトにアクセスしてください。)
- ハードウェアが損傷する原因となるため、CPU を取り付ける前に必ずコンピュータの電源をオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。
- CPU のピン 1 を探します。CPU は間違った方向には差し込むことができません。(または、CPU の両側のノッチと CPU ソケットのアライメントキーを確認します。)
- CPU の表面に熱伝導グリスを均等に薄く塗ります。
- CPU クーラーを取り付けずに、コンピュータの電源をオンにしないでください。CPU が損傷する原因となります。
- CPU の仕様に従って、CPU のホスト周波数を設定してください。ハードウェアの仕様を超えたシステムバスの周波数設定は周辺機器の標準要件を満たしていないため、お勧めできません。標準仕様を超えて周波数を設定したい場合は、CPU、グラフィックスカード、メモリ、ハードドライブなどのハードウェア仕様に従ってください。

A. CPUの向きに注意

マザーボード CPU ソケットのアライメントキーおよび CPU のノッチを確認します。



CPU を取り付ける前に CPU ソケットカバーを取り外さないで下さい。CPU を挿入してロードプレートを開けると、自動的にロードプレートから外れます。

☞ ハードウェア取り付けに関する詳細については、GIGABYTE の Web サイトにアクセスしてください。

<https://www.gigabyte.com/WebPage/210/quick-guide.html?m=sww>

B. CPU を取り付ける

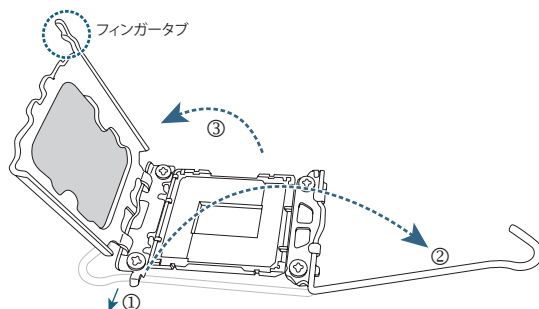
以下のステップに従って、CPU をマザーボードの CPU ソケットに正しく取り付けてください。

①

①CPU ソケットレバーハンドルをそっと押しながら、指でソケットから外します。

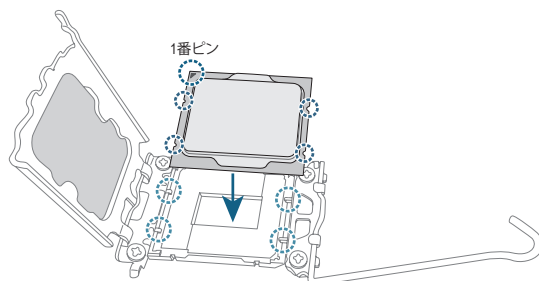
②CPU ソケットロックレバーを完全に持ち上げます。

③金属製ロードプレートの側面にあるフィンガータブを使って、プラスチック製の保護カバーが取り付けられた金属製ロードプレートを持ち上げて開きます。



②

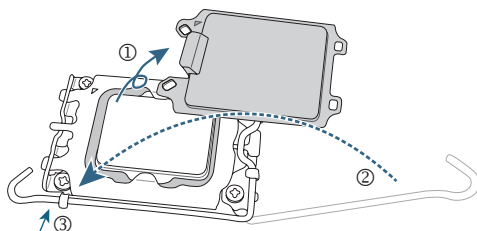
CPUの端を指で持ってください。CPUピン1のマーキング(三角形)をCPUソケットのピン1隅に合わせ(または、CPUノッチをソケットアライメントキーに合わせ)、CPUを所定の位置にそっと差し込みます。



③

CPU が正しく取り付けられていることを確認してから、ロードプレートを閉じます。プラスチック製の保護カバーが飛び出てきますので、それを外してください。保持タブの下でレバーを固定しCPUの取り付けを完了します。

* CPU が装着されていないときは、CPU ソケットを保護するために、必ずプラスチック製の保護カバーを取り付けてください。



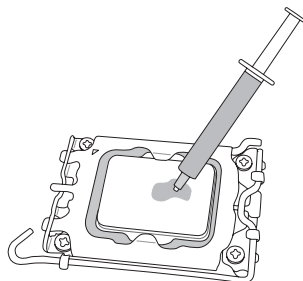
CPU が正しく装着されていない状態で、無理にCPUソケットロックレバーを押し込まないでください。CPU と CPU ソケットが破損する可能性があります。

C. CPUクーラーを取り付ける

必ずCPUを取り付けた後に、CPUクーラーを取り付けてください。(実際の取り付けプロセスは、使用するCPUクーラーによって異なることがあります。CPUクーラーについては、ユーザーズマニュアルを参照してください。)

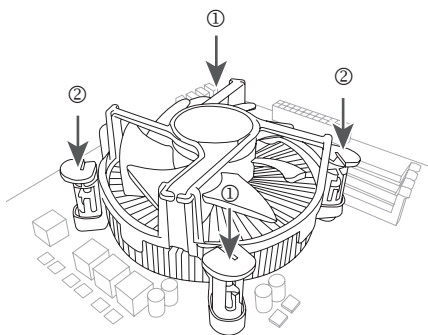
①

取り付けたCPUの表面に熱伝導グリスを均等に薄く塗ります。



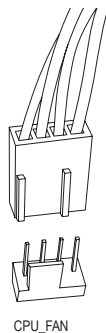
②

クーラーをCPUの上に配置し、マザーボードのピン穴を通して4つのプッシュピンを揃えます。プッシュピンを、対角方向に押し下げてください。



③

最後に、CPUクーラーの電源コネクタをマザーボードのCPUファンヘッダ (CPU_FAN) に取り付けてください。



2-4 メモリの取り付け



メモリを取り付ける前に次のガイドラインをお読みください：

- マザーボードがメモリをサポートしていることを確認してください。同じ容量、ブランド、速度、およびチップのメモリをご使用になることをお勧めします。(サポートされる最新のメモリ速度とメモリモジュールについては、GIGABYTEのWebサイトを参照ください。)
- ハードウェアが損傷する原因となるため、メモリを取り付ける前に必ずコンピュータの電源をオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。
- メモリモジュールは取り付け位置を間違えないようにノッチが設けられています。メモリモジュールは、一方向にしか挿入できません。メモリを挿入できない場合は、方向を変えてください。

デュアルチャンネルのメモリ設定

このマザーボードには 4つのメモリソケットが装備されており、デュアルチャンネルテクノロジーをサポートします。メモリを取り付けた後、BIOS はメモリの仕様と容量を自動的に検出します。デュアルチャンネルメモリモードは、元のメモリバンド幅を 2 倍に拡張します。

4つのメモリソケットが2つのチャンネルに分けられ、各チャンネルには次のように2つのメモリソケットがあります：

- ▶ チャンネル A: DDR5_A1①②/DDR4_A1③④, DDR5_A2①②/DDR4_A2③④
- ▶ チャンネル B: DDR5_B1①②/DDR4_B1③④, DDR5_B2①②/DDR4_B2③④

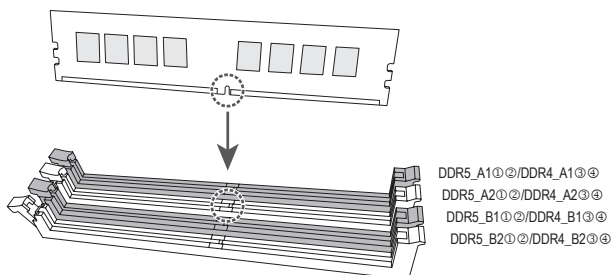
* デュアルチャンネル時の推奨メモリ設定：

	DDR5_A1①② DDR4_A1③④	DDR5_A2①② DDR4_A2③④	DDR5_B1①② DDR4_B1③④	DDR5_B2①② DDR4_B2③④
2つのモジュール	--	DS/SS	--	DS/SS
4つのモジュール	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS

(SS=片面、DS=両面、「-」=メモリなし)

CPU制限により、デュアルチャンネルモードでメモリを取り付ける前に次のガイドラインをお読みください。

- メモリモジュールが1枚のみ取り付けられている場合、デュアルチャンネルモードは有効になりません。
- 2または4枚のモジュールでデュアルチャンネルモードを有効にしているとき、同じ容量、ブランド、速度、チップのメモリを使用するようにお勧めします。



メモリモジュールを1枚のみ装着する場合は、DDR5_A2①②/DDR4_A2③④またはDDR5_B2①②/DDR4_B2③④ソケットに装着することをお勧めします。

- ① B760M DS3H AXのみ。
- ② B760M DS3Hのみ。

- ③ B760M DS3H AX DDR4のみ。
- ④ B760M DS3H DDR4のみ。

2-5 拡張カードを取り付ける

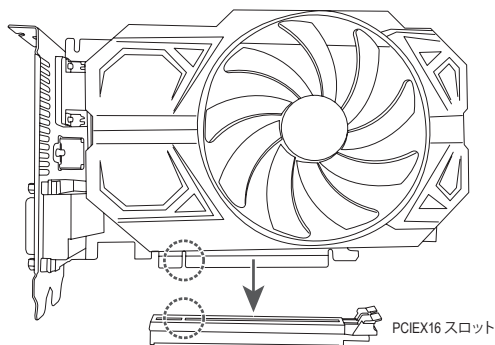


拡張カードを取り付ける前に次のガイドラインをお読みください：

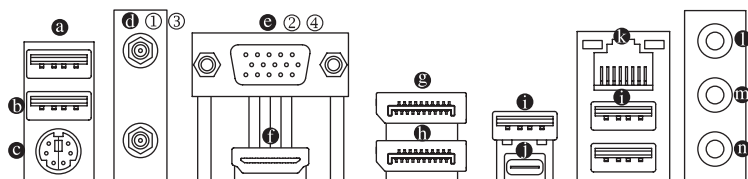
- 拡張カードがマザーボードをサポートしていることを確認してください。拡張カードに付属するマニュアルをよくお読みください。
- ハードウェアが損傷する原因となるため、拡張カードを取り付ける前に必ずコンピュータの電源をオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。

以下のステップに従って、拡張カードを拡張スロットに正しく取り付けてください。

1. カードをサポートする拡張スロットを探します。PCケース背面パネルから、金属製スロットカバーを取り外します。
2. カードをスロットに合わせ、スロットに完全にはまりこむまでカードを押し下げます。
3. 拡張カードが、スロットに完全に装着されたことを確認してください。
4. カードの金属ブラケットをねじでPCケース背面パネルに固定します。
5. 拡張カードをすべて取り付けたら、PCケースカバーを元に戻します。
6. コンピュータの電源をオンにします。必要に応じて、BIOSセットアップに移動し拡張カードに必要なBIOS変更を行います。
7. 拡張カードに付属するドライバをオペレーティングシステムにインストールします。



2-6 背面パネルのコネクター



④ USB 2.0/1.1 Gen 1 ポート (Q-Flash Plus ポート)

USB ポートは USB 2.0/1.1 仕様をサポートします。このポートを USB デバイス用に使用します。Q-Flash Plus^(注1)を使用する前に、このポートに USB フラッシュメモリを挿入してください。

② USB 2.0/1.1 ポート

USB ポートは USB 2.0/1.1 仕様をサポートします。このポートを USB デバイス用に使用します。

③ PS/2 キーボード/マウスポート

このポートを使用して、PS/2 マウスまたはキーボードを接続します。

① SMA アンテナコネクター (2T2R) ① ③

このコネクターを用いてアンテナを接続します。

 アンテナをアンテナコネクターに締めてから、アンテナを正しく向けて、信号の受信を改善します。

⑤ D-Sub ポート^(注2) ② ④

D-Sub ポートは D-Sub 仕様に準拠しており、1920x1200@60 Hz の最大解像度をサポートします。(サポートされる実際の解像度は使用されるモニタによって異なります。) D-Sub 接続をサポートするモニタをこのポートに接続してください。

⑥ HDMI ポート^(注2)

HDMITM HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE HDMI ポートは HDCP 2.3 に対応し、ドルビー TrueHD および DTS HD マスターオーディオ形式をサポートしています。最大 192KHz/24 ビットの 7.1 チャンネル LPCM オーディオ出力もサポートします。このポートを使用して、HDMI をサポートするモニタに接続します。サポートする最大解像度は 4096x2160@60 Hz ですが、サポートする実際の解像度は使用するモニターに依存します。

⑦ DisplayPort^(注2)

DisplayPort は、双方向音声送信をサポートする高品質デジタル画像処理とオーディオを提供します。DisplayPort は、HDCP 2.3 のコンテンツ保護メカニズムをサポートできます。このポートを使用して、DisplayPort をサポートするモニタに接続します。注：DisplayPort 技術は 4096x2304@60 Hz の最大解像度をサポートしますが、サポートされる実際の解像度は使用されるモニタによって異なります。

-  ・ クワッドディスプレイ②④/トリプルディスプレイ①③構成を設定する場合、予めオペレーティングシステムにマザーボードのドライバをインストールする必要があります。
- ・ HDMI/DisplayPort 機器を設置後、必ずデフォルトの音声再生機器を HDMI/DisplayPort に設定してください。(項目名は、オペレーティングシステムによって異なります。)

(注1) Q-Flash Plus 機能を使用するには、GIGABYTE ウェブサイトの「独自機能」のページをご参照ください。

(注2) 実際のサポートは CPU によって異なる場合があります。

① B760M DS3H AX のみ。

③ B760M DS3H AX DDR4 のみ。

② B760M DS3H のみ。

④ B760M DS3H DDR4 のみ。

⑩ DisplayPort (注2)

DisplayPortは、双方向音声送信をサポートする高品質デジタル画像処理とオーディオを提供します。このポートを使用して、DisplayPortをサポートするモニタに接続します。注: DisplayPort 技術は4096x2304@60 Hzの最大解像度をサポートしますが、サポートされる実際の解像度は使用されるモニタによって異なります。

⑪ USB 3.2 Gen 1 ポート

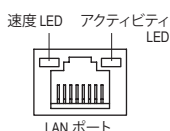
USB 3.2 Gen 1 ポートは USB 3.2 Gen 1 仕様をサポートし、USB 2.0 仕様と互換性があります。このポートを USB デバイス用に使用します。

⑫ USB Type-C®ポート (USB 3.2 Gen 2対応)

リバーシブル USB ポートは USB 3.2 Gen 2 仕様をサポートし、USB 3.2 Gen 1 および USB 2.0 仕様と互換性があります。このポートを USB デバイス用に使用します。

⑬ RJ-45 LAN ポート

Gigabit イーサネット LAN ポートは、最大 2.5 Gbps のデータ転送速度のインターネット接続を提供します。以下は、LAN ポート LED の状態を表します。



速度 LED:

状態	説明
オレンジ	2.5 Gbps のデータ転送速度
緑	1 Gbps のデータ転送速度
オフ	100 Mbps のデータ転送速度

アクティビティ LED :

状態	説明
点滅	データの送受信中です
オフ	データを送受信していません

⑭ ラインイン/リアスピーカーアウト (青)

ラインインジャックです。光ドライブ、ウォークマンなどのデバイスのラインインの場合、このオーディオ端子を使用します。

⑮ ラインアウト/フロントスピーカーアウト (緑)

ラインアウト端子です。

⑯ マイクイン/センター/サブウーファースピーカーアウト (ピンク)

マイクイン端子です。

オーディオジャック設定:

ジャック	ヘッドフォン/ 2 チャンネル	4 チャンネル	5.1 チャンネル	7.1 チャンネル
⑭ ラインイン/リアスピーカーアウト		✓	✓	✓
⑮ ラインアウト/フロントスピーカーアウト	✓	✓	✓	✓
⑯ マイクイン/センター/ サブウーファースピーカーアウト			✓	✓
フロントパネルラインアウト/ サイドスピーカーアウト				✓



オーディオのソフトウェアを使用して、オーディオジャックの機能を変更できます。7.1ch オーディオを設定するには、オーディオソフトウェアにて、設定を行ってください。

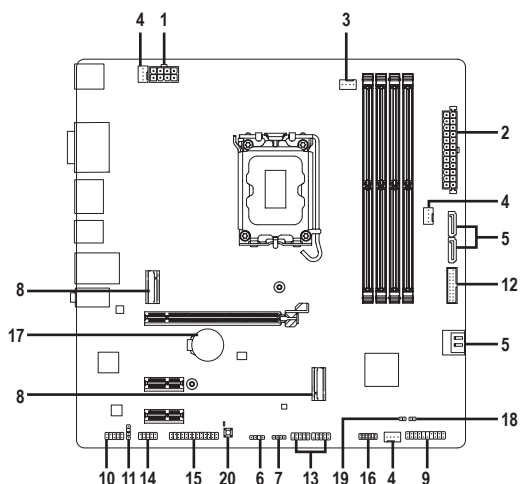
☞ オーディオソフトウェアの詳細設定については、GIGABYTEのWebサイトをご覧ください。

<https://www.gigabyte.com/WebPage/697/realtek897-audio.html>



- 背面/パネルコネクタに接続されたケーブルを取り外す際は、先に周辺機器からケーブルを取り外し、次にマザーボードからケーブルを取り外します。
- ケーブルを取り外す際は、コネクタから真っすぐに引き抜いてください。ケーブルコネクタ内部でショートする原因となるので、横に揺り動かさないでください。

2-7 内部コネクター



1) ATX_12V_2X4	11) SPDIF_O
2) ATX	12) F_U32
3) CPU_FAN	13) F_USB1/F_USB2
4) SYS_FAN1/2/3	14) COM ②④
5) SATA3 4/5/6/7	15) LPT ②④
6) D_LED	16) SPI_TPM
7) LED_C	17) BAT
8) M2A_CPU/M2P_SB	18) CLR_CMOS
9) F_PANEL	19) RST
10) F_AUDIO	20) QFLASH_PLUS

② B760M DS3Hのみ。

④ B760M DS3H DDR4のみ。



外部デバイスを接続する前に、以下のガイドラインをお読みください：

- まず、デバイスが接続するコネクターに準拠していることを確認します。
- デバイスを取り付ける前に、デバイスとコンピュータのパワーがオフになっていることを確認します。デバイスが損傷しないように、コンセントから電源コードを抜きます。
- デバイスを装着した後、コンピュータのパワーをオンにする前に、デバイスのケーブルがマザーボードのコネクターにしっかり接続されていることを確認します。

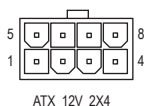
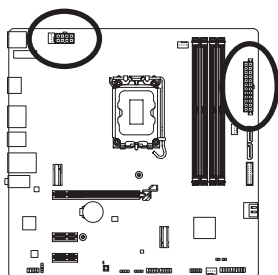
1/2) ATX_12V_2X4/ATX (2x4 12V 電源コネクタと 2x12 メイン電源コネクタ)

電源コネクタを使用すると、電源装置はマザーボードのすべてのコンポーネントに安定した電力を供給することができます。電源コネクタを接続する前に、まず電源装置のパワーがオフになっていること、すべてのデバイスが正しく取り付けられていることを確認してください。電源コネクタは、正しい向きでしか取り付けができないように設計されています。電源装置のケーブルを正しい方向で電源コネクタに接続します。

12V 電源コネクタは、主に CPU に電力を供給します。12V 電源コネクタが接続されていない場合、コンピュータは起動しません。



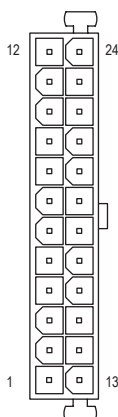
拡張要件を満たすために、高い消費電力に耐えられる電源装置をご使用になることをお勧めします (500W以上)。必要な電力を供給できない電源ユニットをご使用になると、システムが不安定になったり起動できない場合があります。



ATX_12V_2X4

ATX_12V_2X4:

ピン番号	定義	ピン番号	定義
1	GND (2x4ピン12Vのみ)	5	+12V (2x4ピン12Vのみ)
2	GND (2x4ピン12Vのみ)	6	+12V (2x4ピン12Vのみ)
3	GND	7	+12V
4	GND	8	+12V



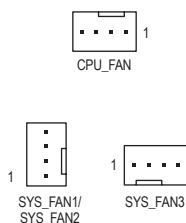
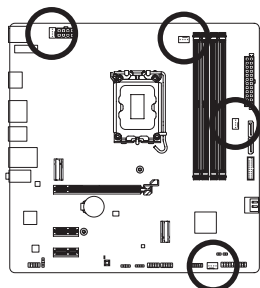
ATX

ATX:

ピン番号	定義	ピン番号	定義
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	GND	15	GND
4	+5V	16	PS_ON(ソフト オン/オフ)
5	GND	17	GND
6	+5V	18	GND
7	GND	19	GND
8	電源良好	20	NC
9	5VSB (スタンバイ +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V (2x12 ピン ATX 専用)	23	+5V (2x12 ピン ATX 専用)
12	3.3V (2x12 ピン ATX 専用)	24	GND (2x12 ピン ATX 専用)

3/4) CPU_FAN/SYS_FAN1/2/3 (ファンヘッダ)

このマザーボードのファンヘッダはすべて4ピンです。ほとんどのファンヘッダは、誤挿入防止設計が施されています。ファンケーブルを接続するとき、正しい方向に接続してください (黒いコネクタワイヤはアース線です)。速度コントロール機能を有効にするには、ファン速度コントロール設計のファンを使用する必要があります。最適の放熱を実現するために、PC ケース内部にシステムファンを取り付けることをお勧めします。



ピン番号	定義
1	GND
2	電圧速度制御
3	検知
4	PWM速度制御

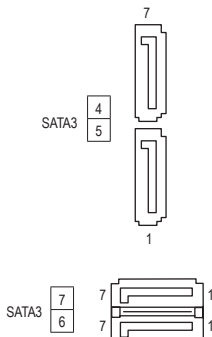
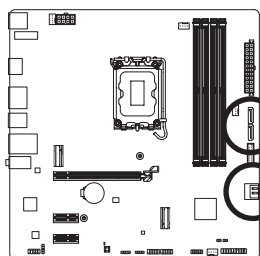
コネクタ	CPU_FAN	SYS_FAN1~3
最大電流	2A	2A
最大電力	24W	24W



- CPUとシステムを過熱から保護するために、ファンケーブルをファンヘッダに接続していることを確認してください。冷却不足はCPUが損傷したり、システムがハングアップする原因となります。
- これらのファンヘッダは設定ジャンパブロックではありません。ヘッダにジャンパキャップをかぶせないでください。

5) SATA3 4/5/6/7 (SATA 6Gb/sコネクタ)

SATA コネクタはSATA 6Gb/s に準拠し、SATA 3Gb/s および SATA 1.5Gb/s との互換性を有しています。それぞれの SATA コネクタは、単一の SATA デバイスをサポートします。SATA コネクタは、RAID 0、RAID 1、RAID 5、および RAID 10 をサポートします。RAID アレイの設定については、GIGABYTE ウェブサイトの「RAID アレイ設定方法」のページをご参照ください。



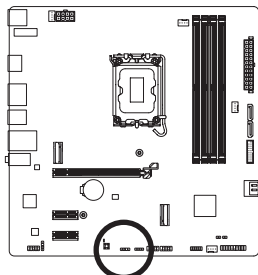
ピン番号	定義
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND



SATAポート ホットプラグを有効にするには、GIGABYTE ウェブサイトの「BIOS セットアップ」ページに移動し、「SATA Configuration」を検索してご参照ください。

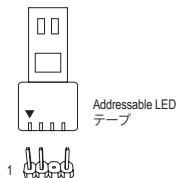
6) D_LED (Addressable LEDテープ用ヘッダ)

ヘッダピンを使用して、最大定格電力5A (5V) およびLED最大1000個の標準5050 addressable LEDテープを接続できます。



1

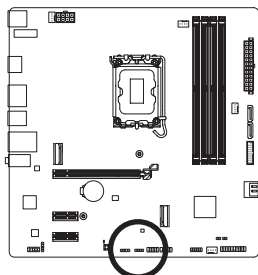
ピン番号	定義
1	V (5V)
2	Data
3	ピンなし
4	GND



Addressable LEDテープをヘッダに接続します。LEDテープ側の電源ピン(プラグの三角印)をaddressable LEDテープヘッダのピン1に接続する必要があります。誤って接続すると、LEDテープが損傷する可能性があります。

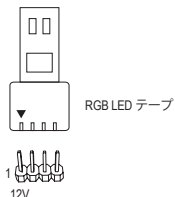
7) LED_C (RGB LEDテープヘッダ)

このヘッダは、標準的なRGB LEDテープ (12V/ G/ R/ B)を使用することができます。また、最大2メートルの長さのケーブルと最大電力2A (12V)までサポートしています。



1

ピン番号	定義
1	12V
2	G
3	R
4	B



RGB LEDテープをヘッダに接続します。LEDテープの電源ピン(プラグの三角印)は、このヘッダのピン1 (12V) に接続する必要があります。誤って接続すると、LEDテープが損傷する可能性があります。



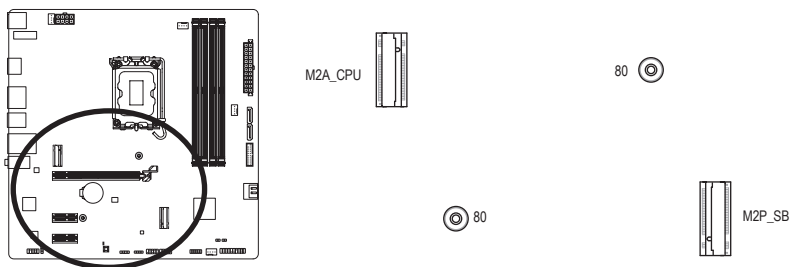
LEDテープの点灯/消灯方法については、GIGABYTEウェブサイトの「独自機能」のページをご参照ください。



デバイスを取り付けまたは取り外す前に、デバイスとコンピュータのパワーがオフになっていることを確認します。デバイスが損傷しないように、コンセントから電源コードを抜きます。"

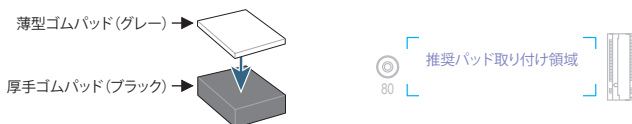
8) M2A_CPU/M2P_SB (M.2 ソケット3 コネクタ)

本マザーボードの M.2 コネクタは、M.2 PCIe SSD のみに対応しています。



・ M.2 ゴムパッドの取り付け (サーマルパッドが事前に取り付けられていない M.2 コネクタにのみ適用):

- 両面 M.2 SSD を使用する場合は、下図のように厚いゴムパッドを推奨配置場所に取り付けます。
- 片面 M.2 SSD を使用する場合は、まず薄いゴムパッドを厚いゴムパッドに貼り付け、次に下図のように推奨配置領域に取り付けます。



ゴムパッドを取り付ける際は、マザーボード上のチップや IC コンポーネントに触れないようにしてください。

M2A_CPU コネクタ:

M.2コネクタにM.2対応SSDに増設する場合、以下の手順に従ってください。

ステップ 1:

ドライバーでヒートシンクのネジを外し、ヒートシンクを取り外します。コネクタに斜めの角度でM.2対応SSDをスライドさせます。

ステップ 2:

ヒートシンク下部のサーマルパッドから保護フィルムを剥がします。その後、ヒートシンクを再設置し、ヒートシンクとM.2 SSD を元の穴にネジで固定します。

M2P_SB コネクタ:

M.2コネクタにM.2対応SSDに増設する場合、以下の手順に従ってください。

ステップ 1:

クリップのつまみを上に引き、取り付け穴から出します。コネクタに斜めの角度でM.2対応SSDをスライドさせます。

ステップ 2:

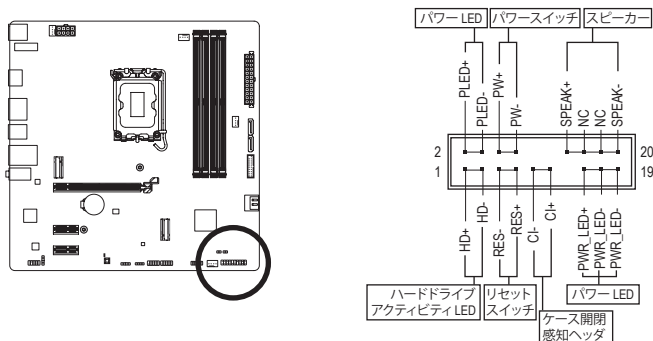
M.2 SSD を押し込んでから、クリップのつまみをマウントホールに押し込んで固定します。

* 各M.2コネクタがサポートするM.2SSDの種類:

	M.2 PCIe x4 SSD	M.2 PCIe x2 SSD	M.2 SATA SSD
M2A_CPU	✓	✓	✗
M2P_SB	✓	✓	✗

9) F. PANEL (前面パネルヘッダ)

下記のピン配列に従い、パワースイッチ、リセットスイッチ、スピーカー、PCケース開閉感知ヘッダ、ケースのインジケータ（パワーLEDやHDD LEDなど）を接続します。接続する際には、+と-のピンに注意してください。



• PLED/PWR_LED (電源LED):

システムステータス	LED
S0	オン
S3/S4/S5	オフ

PCケース前面パネルの電源ステータスインジケータに接続します。システムが作動しているとき、LED はオンになります。システムが S3/S4 スリープ状態に入っているとき、またはパワーがオフになっているとき (S5)、LED はオフになります。

• PW (パワースイッチ):

PCケース前面パネルの電源ステータスインジケータに接続します。パワースイッチを使用してシステムのパワーをオフにする方法を設定できます (詳細はGIGABYTE ウェブサイトの「BIOS セットアップ」ページに移動し、「Soft-Off by PWR-BTTN」をご参照ください)。

• SPEAK (スピーカー):

PCケースの前面パネル用スピーカーに接続します。システムは、ビープコードを鳴らすことでシステムの起動ステータスを報告します。システム起動時に問題が検出されない場合、短いビープ音が1度鳴ります。

• HD (ハードドライブアクティビティ LED):

PCケース前面パネルのハードドライブアクティビティLED に接続します。ハードドライブがデータの読み書きを行っているとき、LED はオンになります。

• RES (リセットスイッチ):

PCケース前面パネルのリセットスイッチに接続します。コンピュータがフリーズし通常の再起動を実行できない場合、リセットスイッチを押してコンピュータを再起動します。

• CI (PCケース開閉感知ヘッダ):

PCケースカバーが取り外されている場合、PCケースの検出可能なPCケース開閉感知スイッチ/センサーに接続します。この機能は、PCケース開閉感知スイッチ/センサーを搭載したPCケースを必要とします。

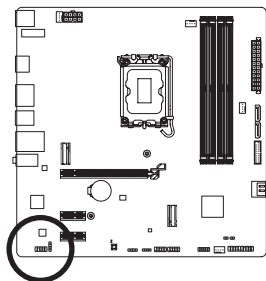
• NC:接続なし。



前面パネルのデザインは、ケースによって異なります。前面パネルモジュールは、パワースイッチ、リセットスイッチ、電源LED、ハードドライブアクティビティLED、スピーカーなどで構成されています。ケース前面パネルモジュールをこのヘッダに接続しているとき、ワイヤ割り当てとピン割り当てが正しく一致していることを確認してください。

10) F_AUDIO (前面パネルオーディオヘッダ)

フロントパネルオーディオヘッダは、High Definition audio (HD)をサポートします。PCケース前面パネルのオーディオモジュールをこのヘッダに接続することができます。モジュールコネクターのワイヤ割り当てが、マザーボードヘッダのピン割り当てに一致していることを確認してください。モジュールコネクタとマザーボードヘッダ間の接続が間違っていると、デバイスは作動せず損傷することがあります。



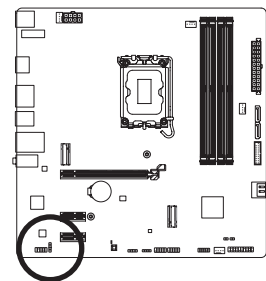
ピン番号	定義
1	MIC L
2	GND
3	MIC R
4	NC
5	Head Phone R
6	MIC Detection
7	SENSE_SEND
8	ピンなし
9	Head Phone L
10	Head Phone Detection



PCケースの中には、前面パネルのオーディオモジュールを組み込んで、単一コネクタの代わりに各ワイヤのコネクタを分離しているものもあります。ワイヤ割り当てが異なっている前面パネルのオーディオモジュールの接続方法の詳細については、PCケースメーカーにお問い合わせください。

11) SPDIF_O (S/DPDIF出力用ヘッダ)

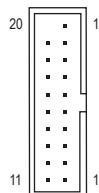
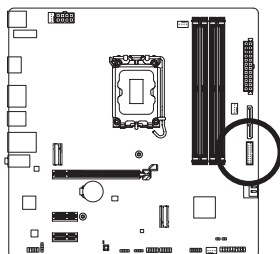
このヘッダはS/DPDIFデジタル出力に対応しており、S/DPDIFデジタル・オーディオケーブルを接続することで、マザーボードから対応するオーディオ機器にデジタル・オーディオを出力することができます。デジタル・オーディオケーブルの接続については、お使いのオーディオ機器のマニュアルをよくお読みください。



ピン番号	定義
1	5VDUAL
2	ピンなし
3	SPDIFO
4	GND

12) F_U32 (USB 3.2 Gen 1 ヘッド)

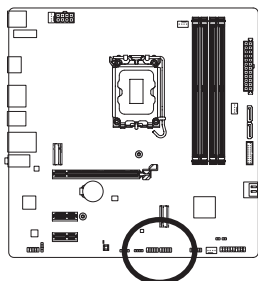
ヘッドはUSB 3.2 Gen 1およびUSB 2.0仕様に準拠し、2つのUSBポートが装備されています。USB 3.2 Gen 1対応2ポートを装備するオプションの3.5"フロントパネルのご購入については、販売店にお問い合わせください。



ピン番号	定義	ピン番号	定義
1	VBUS	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	GND
4	GND	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	GND
7	GND	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS
10	NC	20	ピンなし

13) F_USB1/F_USB2 (USB 2.0/1.1 ヘッド)

ヘッドはUSB 2.0/1.1仕様に準拠しています。各USBヘッドは、オプションのUSBブラケットを介して2つのUSBポートを提供できます。オプションのUSBブラケットを購入する場合は、販売店にお問い合わせください。



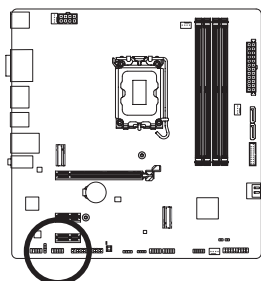
ピン番号	定義
1	電源 (5V)
2	電源 (5V)
3	USB DX-
4	USB DY-
5	USB DX+
6	USB DY+
7	GND
8	GND
9	ピンなし
10	NC



USBブラケットを取り付ける前に、USBブラケットが損傷しないように、コンピュータの電源をオフにしてからコンセントから電源コードを抜いてください。

14) COM (シリアルポートヘッダ) ②④

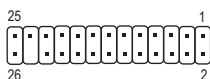
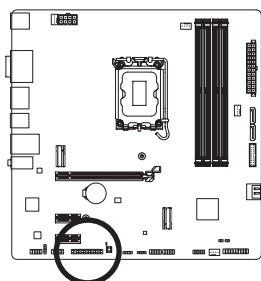
COM ヘッダは、オプションの COM ポートケーブルを介して 1 つのシリアルポートを提供します。オプションの COM ポートケーブルを購入する場合、販売店にお問い合わせください。



ピン番号	定義
1	NDCD-
2	NSIN
3	NSOUT
4	NDTR-
5	GND
6	NDSR-
7	NRTS-
8	NCTS-
9	NRI-
10	ピンなし

15) LPT (パラレルポートヘッダ) ②④

LPT ヘッダは、オプションの LPT ポートケーブルによって 1 つのパラレルポートを利用できます。オプションの LPT ポートケーブルを購入する場合、販売店にお問い合わせください。



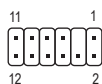
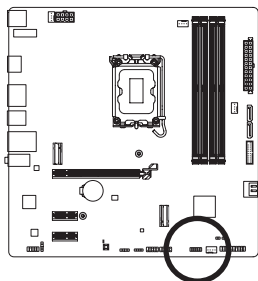
ピン番号	定義	ピン番号	定義
1	STB-	14	GND
2	AFD-	15	PD6
3	PD0	16	GND
4	ERR-	17	PD7
5	PD1	18	GND
6	INIT-	19	ACK-
7	PD2	20	GND
8	SLIN-	21	BUSY
9	PD3	22	GND
10	GND	23	PE
11	PD4	24	ピンなし
12	GND	25	SLCT
13	PD5	26	GND

② B760M DS3Hのみ。

④ B760M DS3H DDR4のみ。

16) SPI_TPM (TPMモジュール用ヘッダ)

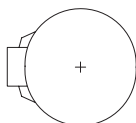
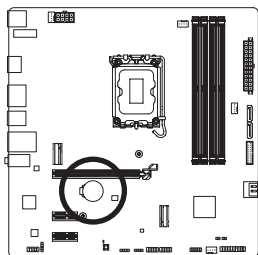
SPI TPM (TPMモジュール) をこのヘッダに接続できます。



ピン番号	定義
1	データ出力
2	電源 (3.3V)
3	ピンなし
4	NC
5	データ入力
6	CLK
7	チップ選択
8	GND
9	IRQ
10	NC
11	NC
12	RST

17) BAT (バッテリー)

バッテリーは、コンピュータがオフになっているとき CMOS の値 (BIOS 設定、日付、および時刻情報など) を維持するために、電力を提供します。バッテリーの電圧が低レベルまで下がったら、バッテリーを交換してください。CMOS 値が正確に表示されなかったり、失われる可能性があります。



バッテリーを取り外すと、CMOS 値を消去できます：

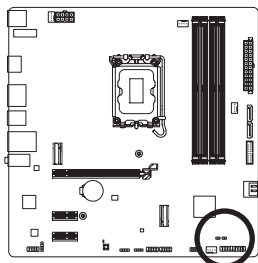
1. コンピュータのパワーをオフにし、電源コードを抜きます。
2. バッテリーホルダからバッテリーをそっと取り外し、1 分待ちます。(または、ドライバーのような金属物体を使用してバッテリーホルダの+と-の端子に触れ、5 秒間ショートさせます。)
3. バッテリーを交換します。
4. 電源コードを差し込み、コンピュータを再起動します。



- バッテリーを交換する前に、常にコンピュータのパワーをオフにしてから電源コードを抜いてください。
- バッテリーを同等のバッテリーと交換します。誤ったバッテリーモデルに交換した場合、ご使用の機器が破損する場合がありますのでご注意ください。
- バッテリーを交換できない場合、またはバッテリーのモデルがはっきり分からない場合、購入店または販売店にお問い合わせください。
- バッテリーを取り付けるとき、バッテリーのプラス側 (+) とマイナス側 (-) の方向に注意してください (プラス側を上に向ける必要があります)。
- 使用済みのバッテリーは、地域の環境規制に従って処理してください。

18) CLR_CMOS (CMOSクリアジャンパ)

このジャンパを使用して BIOS 設定をクリアするとともに、CMOS 値を出荷時設定にリセットします。CMOS値を初期化するには、ドライバーのような金属製品を使用して2つのピンに数秒間触れます。



オープン:Normal



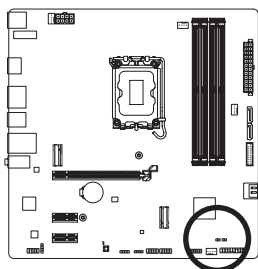
ショート:CMOSのクリア



- CMOS値を初期化する前に、常にコンピュータのパワーをオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。
- システムが再起動した後、BIOS設定を工場出荷時に設定するか、手動で設定してください(Load Optimized Defaults 選択) BIOS 設定を手動で設定します(詳細は GIGABYTE ウェブサイトの「BIOS セットアップ」ページをご参照ください)。

19) RST (リセットジャンパ)

PCケース前面パネルのリセットスイッチを、リセットジャンパに接続します。コンピュータがフリーズし通常の再起動を実行できない場合、リセットスイッチを押してコンピュータを再起動します。



1

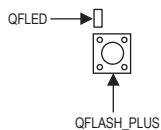
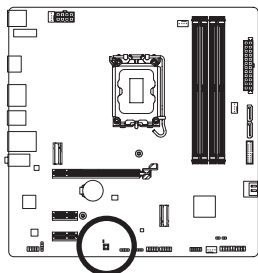
ピン番号	定義
1	リセット
2	GND



リセットジャンパは、いくつかの機能を切り替えて使用することができます。別のタスクを実行するためにボタンをリマップするには、詳細については、GIGABYTE ウェブサイトの「BIOSセットアップ」ページに移動し、「RST (MULTIKEY)」を検索してご参照ください。

20) QFLASH_PLUS (Q-Flash Plus ボタン)

Q-Flash Plus では、システムの電源が切れているとき (S5シャットダウン状態) に BIOS を更新することができます。最新の BIOS を USB メモリに保存して専用ポートに接続すると、Q-Flash Plus ボタンを押すだけで自動的に BIOS を更新できます。QFLED は、BIOS のマッチングおよび更新作業が開始されると点滅し、メイン BIOS の書換が完了すると点滅を停止します。



Q-Flash Plus機能を使用するには、GIGABYTE ウェブサイトの「独自機能」のページをご参照ください。

第 3 章 BIOS セットアップ

BIOS (Basic Input and Output System) は、マザーボード上の CMOS にあるシステムのハードウェアのパラメータを記録します。主な機能には、システム起動、システムパラメータの保存、およびオペレーティングシステムの読み込みなどを行うパワー オンセルフテスト (POST) の実行などがあります。BIOS には、ユーザーが基本システム構成設定の変更または特定のシステム機能の有効化を可能にする BIOS セットアッププログラムが含まれています。

電源をオフにすると、CMOS の設定値を維持するためマザーボードのバッテリーが CMOS に必要な電力を供給します。

BIOS セットアッププログラムにアクセスするには、電源オン時の POST 中に <Delete> キーを押します。

BIOS をアップグレードするには、GIGABYTE Q-Flash または Q-Flash Plus ユーティリティのいずれかを使用します。

- Q-Flash により、ユーザーはオペレーティングシステムに入ることなく BIOS のアップグレードまたはバックアップを素早く簡単に行えます。
- Q-Flash Plus では、システムの電源が切れているとき (S5シャットダウン状態) に BIOS を更新することができます。最新の BIOS を USB メモリに保存して専用ポートに接続すると、Q-Flash Plus ボタンを押すだけで自動的に BIOS を更新できます。

Q-Flash および Q-Flash Plus ユーティリティの使用に関する使用説明については、GIGABYTE のウェブサイトの「独自機能」ページに移動し、「BIOS Update Utilities」を検索してご参照ください。



- BIOS の更新は潜在的に危険を伴うため、BIOS の現在のバージョンを使用しているときに問題が発生していない場合、BIOS を更新しないことをお勧めします。BIOS の更新は注意して行ってください。BIOS の不適切な更新は、システムの誤動作の原因となります。
- システムの不安定またはその他の予期しない結果を防ぐために、初期設定を変更しないことをお勧めします (必要な場合を除く)。誤った BIOS 設定しますと、システムは起動できません。そのようなことが発生した場合は、CMOS 値を既定値にリセットしてみてください。
- CMOS クリアする方法については、第 2 章のバッテリー/CMOS クリアジャンプ概要を参照して、または GIGABYTE ウェブサイトの「BIOS セットアップ」ページにアクセスし、「Load Optimized Defaults」で CMOS 値をクリアする方法を検索してご参照ください。

☞ BIOS セットアップの詳細設定については、GIGABYTE の Web サイトをご覧ください。

<https://www.gigabyte.com/WebPage/928/intel700-bios.html>

起動画面：

コンピュータが起動するとき、次の起動ロゴ画面が表示されます。



機能キー：

:BIOS SETUP/Q-FLASH

<Delete>キーを押してBIOSセットアップに入り、BIOSセットアップでQ-Flashユーティリティにアクセスします。

<F12>:BOOT MENU

起動メニューにより、BIOSセットアップに入ることなく第1起動デバイスを設定できます。起動メニューで、上矢印キー<↑>または下矢印キー<↓>を用いて第1起動デバイスを選択し、次に<Enter>キーを押して確定します。システムはそのデバイスから起動します。

注：起動メニューの設定は1回のみ有効です。システム再起動後のデバイスの起動順序はBIOSセットアップの設定の順序となります。

<END>:Q-FLASH

<End>キーを押すと、先にBIOSセットアップに入る必要なく直接Q-Flash Utilityにアクセスします。

第4章 オペレーティングシステムとドライバをインストールする

4-1 オペレーティングシステムのインストール

BIOS設定が正しければ、オペレーティングシステムをいつでもインストールできます。

RAID ボリュームに OS をインストールする場合は、OS インストール時にまず Intel® RST VMD コントローラーのドライバーをインストールする必要があります。以下のステップを参照してください。

ステップ 1:

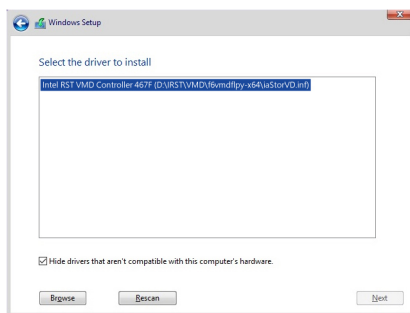
GIGABYTE のウェブサイトアクセスし、マザーボード型番の製品ウェブページを参照し、**Support | Download | SATA RAID / AHCI** ページ欄から **Intel SATA Preinstall driver** ファイルをダウンロードし、ファイルを解凍して USB メモリにコピーしてください。

ステップ 2:

Windows セットアップディスクからブートし、標準の OS インストールステップを実施します。画面でドライバを読み込んでくださいという画面が表示されたら、**Browse** を選択します。

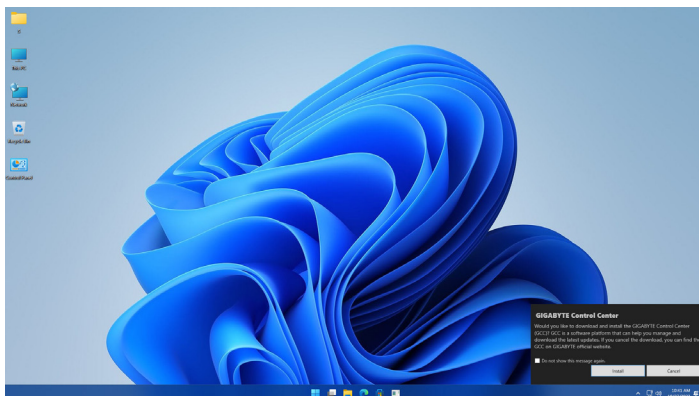
ステップ 3:

USB メモリドライブを挿入し、ドライバの場所を閲覧します。下図に示した画面が表示されたら、**Intel RST VMD Controller 467F** を選択し、**Next** をクリックしてドライバをロードし OS のインストールを続行します。

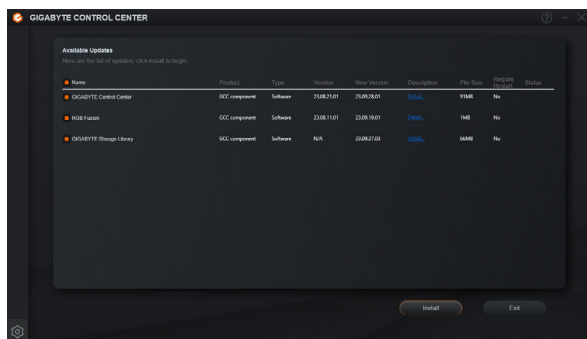


4-2 ドライバのインストール

オペレーティング・システムをインストールした後、GIGABYTE Control Center (GCC) 経由でドライバとGIGABYTEアプリケーションをダウンロードしてインストールするかどうかを尋ねる、ダイアログボックスがデスクトップの右下隅に表示されます。**Install**をクリックしてインストールを続行します。(BIOS設定画面で、**Settings****Gigabyte Utilities Downloader Configuration****Gigabyte Utilities Downloader**が有効に設定されていることを確認してください。)



End User License Agreement (使用許諾契約書)ダイアログボックスが表示されたら、<Accept (同意する)>を押してGIGABYTE Control Center (GCC)をインストールします。GIGABYTE CONTROL CENTER画面で、インストールしたいドライバとアプリケーションを選択して**Install**をクリックしてください。



インストールの前に、システムがインターネットに接続されていることを確認してください。

- ソフトウェアについては、GIGABYTEのウェブサイトアクセスしてください。

<https://www.gigabyte.com/WebPage/926/intel700-app.html>

- トラブルシューティング情報については、GIGABYTEのウェブサイトアクセスしてください。

<https://www.gigabyte.com/WebPage/351/faq.html>

第 5 章 付録

5-1 RAID セットを設定する

RAIDレベル

	RAID 0	RAID 1	RAID 5	RAID 10
ハードドライブの最小数	≥2	2	≥3	4
アレイ容量	ハードドライブの数 * 最小ドライブのサイズ	最小ドライブのサイズ	(ハードドライブの数 - 1) * 最小ドライブのサイズ	(ハードドライブの数 / 2) * 最小ドライブのサイズ
耐故障性	いいえ	はい	はい	はい

始める前に、以下のアイテムを用意してください：

このマザーボードは、SATA RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10 に対応しています。RAID アレイを構成する前に、上の表に示されているように正しい数のハードドライブを準備してください。

- SATA/ハードドライブまたはSSDs。最適のパフォーマンスを発揮するために、同じモデルと容量のハードドライブを2台使用することをお勧めします。
- Windows セットアップディスク。
- インターネットに接続されたコンピュータ。
- USB メモリドライブ。



Intel® B760 チップセットは、NVMe SSD ストレージデバイスの RAID 0、RAID 1、RAID 5、および RAID 10 機能を搭載していません。

☞ RAIDアレイの構成の詳細については、GIGABYTEのWebサイトをご覧ください。

<https://www.gigabyte.com/WebPage/927/intel700-raid.html>

Regulatory Notices

United States of America, Federal Communications Commission Statement

Supplier's Declaration of Conformity 47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Product Name: **Motherboard**
Trade Name: **GIGABYTE**
Model Number: **B760M DS3H AX/B760M DS3H/B760M DS3H AX DDR4/B760M DS3H DDR4**

Responsible Party – U.S. Contact Information: **G.B.T. Inc.**
Address: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748
Tel.: 1-626-854-9338
Internet contact information: <https://www.gigabyte.com>

FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B, Unintentional Radiators.
Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The FCC with its action in ET Docket 96-8 has adopted a safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC certified equipment. The Intel PRO/Wireless 5000 LAN products meet the Human Exposure limits found in OET Bulletin 65, 2001, and ANSI/IEEE C95.1, 1992. Proper operation of this radio according to the instructions found in this manual will result in exposure substantially below the FCC's recommended limits.

The following safety precautions should be observed:

- Do not touch or move antenna while the unit is transmitting or receiving.
- Do not hold any component containing the radio such that the antenna is very close or touching any exposed parts of the body, especially the face or eyes, while transmitting.
- Do not operate the radio or attempt to transmit data unless the antenna is connected; if not, the radio may be damaged.
- Use in specific environments:
 - The use of wireless devices in hazardous locations is limited by the constraints posed by the safety directors of such environments.
 - The use of wireless devices on airplanes is governed by the Federal Aviation Administration (FAA).
 - The use of wireless devices in hospitals is restricted to the limits set forth by each hospital.

Antenna use:

In order to comply with FCC RF exposure limits, low gain integrated antennas should be located at a minimum distance of 7.9 inches (20 cm) or more from the body of all persons.

Explosive Device Proximity Warning

Warning: Do not operate a portable transmitter (such as a wireless network device) near unshielded blasting caps or in an explosive environment unless the device has been modified to be qualified for such use.

Antenna Warning

The wireless adapter is not designed for use with high-gain antennas.

Use On Aircraft Caution

Caution: Regulations of the FCC and FAA prohibit airborne operation of radio-frequency wireless devices because their signals could interfere with critical aircraft instruments.

Other Wireless Devices

Safety Notices for Other Devices in the Wireless Network: Refer to the documentation supplied with wireless Ethernet adapters or other devices in the wireless network.

Canada, Canada-Industry Notice:

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
 - (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- Cet appareil est conforme aux normes Canada d'Industrie de RSS permis-exempt. L'utilisation est assujéti aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15-to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25-to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or

damage to this device. The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25-to 5.35 and 5.725 to 5.85 GHz frequency range in point-to-point operation. To comply with RF exposure requirements all antennas should be located at a minimum distance of 20cm, or the minimum separation distance allowed by the module approval, from the body of all persons.

Attention: l'utilisation d'un réseau sans fil IEEE802.11a est restreinte à une utilisation en intérieur à cause du fonctionnement dans la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz. Industry Canada requiert que ce produit soit utilisé à l'intérieur des bâtiments pour la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz afin de réduire les possibilités d'interférences nuisibles aux canaux co-existants des systèmes de transmission satellitaires. Les radars de puissances ont fait l'objet d'une allocation primaire de fréquences dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.65-5.85 GHz. Ces stations radar peuvent créer des interférences avec ce produit et/ou lui être nuisible. Le gain d'antenne maximum permise pour une utilisation avec ce produit est de 6 dBi afin d'être conforme aux limites de puissance isotropique rayonnée équivalente (P.I.R.E.) applicable dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.725-5.85 GHz en fonctionnement point-à-point. Pour se conformer aux conditions d'exposition de RF toutes les antennes devraient être localisées à une distance minimum de 20 cm, ou la distance de séparation minimum permise par l'approbation du module, du corps de toutes les personnes.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be chosen so that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radio électrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, Radio Equipment Directive 2014/53/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the 2015/863 Statement.

This product has been tested and found to comply with all essential requirements of the Directives.

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement

GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

Battery Information

European Union—Disposal and recycling information
GIGABYTE Recycling Program (available in some regions)



This symbol indicates that this product and/or battery should not be disposed of with household waste. You must use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

Déclaration de Conformité aux Directives de l'Union européenne (UE)

Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l'UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, directive Basse Tension 2014/35/UE, directive équipements radioélectriques 2014/53/UE, la directive RoHS II 2011/65/UE & la déclaration 2015/863. La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

European Union (EU) CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkt mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, Funkanlagen Richtlinie 2014/53/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt und die 2015/863 Erklärung.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden Standards zur Europäischen Normierung beurteilt.

CE declaração de conformidade

Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Diretiva CEM 2014/30/EU; Diretiva RSP 2011/65/EU e a declaração 2015/863.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Declaración de conformidad

Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de equipamientos de radio 2014/53/EU, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Declaración 2015/863.

El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

CE Dichiarazione di conformità

I prodotti con il marchio CE sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva di apparecchiature radio 2014/53/UE, Direttiva RoHS 2011/65/UE e Dichiarazione 2015/863.

La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

Deklaracja zgodności UE Unii Europejskiej

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa urządzeń radiowych 2014/53/UE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i dyrektywa 2015/863.

Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami dyrektywy.

ES Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU, Směrnice RoHS 2011/65/EU a 2015/863.

Tento produkt byl testován a bylo shledáno, že splňuje všechny základní požadavky směrnice.

EK megfeleléségi nyilatkozata

A termék megfelelnek az alábbi irányelvek és szabványok követelményeinek, azok a kiállításidőpontjában érvényes, aktuális változatában: EMC irányelv 2014/30/EU, Kisfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/35/EU, rádióberendezések irányelv 2014/53/EU, RoHS irányelv 2011/65/EU és 2015/863.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Είναι οι συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλή τάση 2014/35/ΕΕ, Οδηγία 2014/53/ΕΕ σε ραδιοεπικοινωνίες, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και 2015/863.

Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

- Battery type: CR2032
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries, batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- For treatment information, call a local poison control center.
- The product contains non-replaceable batteries.

European Community Directive R&TTE Directive Compliance Statement:

This equipment complies with all the requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Directive 2014/53/EU.

The IEEE 802.11 wireless LAN 5.15 GHz~5.35 GHz and/or Wi-Fi 6E Low Power Indoor 5.945 GHz~6.425 GHz (or 5.925 GHz~6.425 GHz in UK) frequency bands are restricted for indoor use only in all countries listed in the matrix below.

		AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
		DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
		HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
		LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE
		SI	SK	TR				

UK The Radio Equipment Regulations 2017 Statement:

This equipment complies with all the requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Regulations 2017.

The IEEE 802.11 wireless LAN 5.15 GHz~5.35 GHz and/or Wi-Fi 6E Low Power Indoor 5.925 GHz~6.425 GHz frequency bands are restricted for indoor use only.



NCC Wireless Statements / 無線設備警告聲明：

低功率電波輻射性電機管理辦法

- (1) 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- (2) 應避免影響附近雷達系統之操作。

Korea KCC NCC Wireless Statement:

5.25GHz - 5.35 GHz 대역을 사용하는 무선 장치는 실내에서만 사용하도록 제한됩니다.

Japan Wireless Statement:

5.15 GHz 帯 ~ 5.35 GHz 帯 & 6GHz LPI 帯：屋内のみの使用。

Wireless module approvals:

To identify your Motherboard version or revision number, look for "REV: X.X" printed on the PCB on the top left corner of the Motherboard. For example, "REV:1.0" means the revision of the motherboard is 1.0.

Motherboard revision no.:	Wireless module manufacturer, model name:
B760M DS3H AX rev. 1.0	AMD Corporation RZ608, MediaTek MT7921K
B760M DS3H AX rev. 1.1	Intel® Corporation AX210NGW
B760M DS3H AX rev. 1.2	Intel® Corporation AX211NGW
B760M DS3H AX rev. 1.3	Realtek Semiconductor Corp. RTL8852CE
B760M DS3H AX DDR4 rev. 1.0	AMD Corporation RZ608, MediaTek MT7921K
B760M DS3H AX DDR4 rev. 1.1	Intel® Corporation AX210NGW
B760M DS3H AX DDR4 rev. 1.2	Intel® Corporation AX211NGW
B760M DS3H AX DDR4 rev. 1.3	Realtek Semiconductor Corp. RTL8852CE

Approvals for wireless module RZ608, MediaTek MT7921K:

United States FCC: FCC ID: RAS-MT7921K	India WPC: ETA-SD-20201007013	Qatar CRA: CRASM2020S-0005758	 CCAI20LP2410T7
Canada ISED: IC ID: 7542A-MT7921K	Japan 総務省:  R 020 200172 T D20 0066 020 5.15~5.35GHz 屋内限定 5.15~5.35GHz indoor use only	Serbia: P1620165500	
Australia ACMA: 	Kuwait CITRA: CITRA: 4472	Singapore IMDA:  Complies with IMDA standards HS004-20	Ukraine:  UA.032.CT.0411-20
Brazil:  ANATEL 16810-20-08766		South Korea NRRA:  R-C-MD6-MT7921K	United Kingdom: 
China CMIIT: CMIIT ID: 2020AP14016(M)	Pakistan PTA: Approved by PTA	상호명: Mediatek Inc. 모델명: MT7921K 인증연월일: 2020/12 제조사/제조국: Mediatek Inc./China	
Europe: 			

Approvals for wireless module AX210NGW:

United States FCC: FCC ID: PD9AX210NG	Europe: 	Pakistan PTA: Approved by PTA TAC no.: 9.1000/2020	
Canada ISED: IC: 1000M-AX210NG		Serbia: 	
Australia ACMA: 	India WPC: ETA-SD-20201006833	Ukraine: 	United Kingdom: 
Brazil:  14242-20-04423	Japan 総務省:  R 003-220254 T D220163003 5GHz band (W53,W53) and 6GHz (LPI) Indoor use only (Except communicate to W52 high power radio)	Singapore IMDA:  Complies with IMDA standards DA108442	
Belarus: 	Oman TRA: Applicant number: D080001 Approval number: TRA/TA-R/10113/20	South Korea NRRA:  R-C-INT-AX210NGW 1.상호명: INTEL CORPORATION 2.기자재의 명칭(모델명): 특정소출력 무선기기 (무선랜을 포함한 무선랜시스템용 무선기기) AX210NGW 3.제조사명: 2020/09 4.제조지/제조국: Intel Corporation / China, Taiwan	
China CMIIT: CMIIT ID: 2020AJ11402 (M)			

Approvals for wireless module AX211NGW:

United States FCC: FCC ID: PD9AX211NG	Europe: 	Pakistan PTA: Approved by PTA TAC no.: 9.308/2021	
Canada ISED: IC: 1000M-AX211NG		Serbia: 	
Australia ACMA: 	India WPC: ETA-SD-20210301679	Ukraine: 	United Kingdom: 
Brazil:  12069-21-04423	Japan 総務省:  R 003-220256 T D220165003 5GHz (W52,W53): 屋内限定 5GHz band (W52,W53): indoor use only	Singapore IMDA:  Complies with IMDA standards DA108442	
Belarus: 	Oman TRA: Applicant number: D080001 Approval no: TRA/TA-R/11342/21	South Korea NRRA:  R-C-INT-AX211NGW 1.상호명: INTEL CORPORATION 2.기자재의 명칭(모델명): 특정소출력 무선기기 (무선랜을 포함한 무선랜시스템용 무선기기) AX211NGW 3.제조사명: 2021/03 4.제조지/제조국: Intel Corporation/China,Taiwan	
China CMIIT: CMIIT ID: 2021AJ3091 (M)			

Approvals for wireless module RTL8852CE:

United States FCC: FCC ID: TX2-RTL8852CE	Europe: 	Pakistan PTA: Approved by PTA TAC no.: 9.1176/2022	South Korea NRRA: 
Canada ISED: IC: 6317A-RTL8852CE		Serbia: 	
Australia ACMA: 	India WPC: ETA-SD-20220908233	Ukraine: 	
Brazil:  20275-22-04076	Japan 総務省:  T D220076020 R 020-220232 電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。 (法令により許可された場合を除く) 電波法により6GHzは屋外使用禁止です。	Singapore IMDA:  Complies with IMDA standards DA105282	United Kingdom: 
China CMIIT: CMIIT ID: 2022AJ9304(M)			



連絡先

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.

アドレス: No.6, Baoqiang Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231

TEL: +886-2-8912-4000、FAX: +886-2-8912-4005

技術および非技術サポート(販売/マーケティング): <https://esupport.gigabyte.com>

WEBアドレス(英語): <https://www.gigabyte.com>

WEBアドレス(中国語): <https://www.gigabyte.com/tw>

- **GIGABYTE eSupport**

技術的または技術的でない(販売/マーケティング) 質問を送信するには:
<https://esupport.gigabyte.com>

The screenshot shows the GIGABYTE eSupport landing page. At the top left is the GIGABYTE logo. The main heading is "Welcome to eSupport" in blue. Below it, a message states: "Submit your product/sponsorship/marketing questions or inquiries, and our representative will respond in a timely fashion." The page is divided into three main sections: "NEWS", "SIGN IN", and "QUICK LINK". The "NEWS" section contains a message about submission status. The "SIGN IN" section has fields for "Account" and "Password", a "sign in with" button with social media icons (Facebook, Google, Twitter, Microsoft), and links for "Register", "Forgot Password", and a "SIGN IN" button. The "QUICK LINK" section has icons for "Downloads", "FAQ", and "Warranty".